

## 有机硅增粘剂 SK-AP9176

### 产品特性：

- 显著提高加成型硅胶对金属、聚烯烃等材质的粘接；
- 含“乙烯基”反应型。

### 技术指标：

检测项目	典型数据	检测标准
外观	微黄透明液体	目测
运动粘度 (mm <sup>2</sup> /s@25℃)	30~150	GB/T 10247-2008
折光率 (25℃)	1.44~1.46	GB/T 6488
乙烯基含量 (wt%)	6.0~7.0	硫代硫酸钠返滴定法

### 典型应用：

- LED 封装硅胶：促进苯基硅树脂对 PPA、镀银等材质的粘接；
- 有机硅离型剂：提升离型剂对基材的锚固性能，极小的离型力爬升；

### 使用方法：

- 任意组分添加，添加量为硅胶总量 0.5~2%；
- 建议 100℃以上固化硅胶，固化时间视具体应用而定。

### 包装贮运：

- SK-AP9176 按 5KG/桶，20KG/箱包装；
- 请室温、通风、避雨防潮下保存；
- 本品非易燃易爆品，按非危险品运输；
- 自生产日期起，6 个月内使用最佳，超期复检，合格后方可使用。

### 安全与环保：

- 使用本品前，请确保佩戴相应的防护工具，具体细则请阅读产品物质安全资料；
- 使用后的包装物，请按当地固废法规处理。

### 提示：

- 本文件所载是我司认为可靠的资料，所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识，具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制，所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整，如有需要，可与技术部工程师联系。